

「ダイシングソー」の紹介

○電子材料基板(半導体ウェハ、セラミックス基板など)や小型電子デバイスを精密に切断・加工する装置です。

パワー半導体向け基板素材(SiCやGaNなど)や小型電子デバイスを精密加工・切断することができます。ワークの寸法データやアライメントなどの加工条件の設定、加工後のカーフチェックによる品質確認は、タッチパネル操作で容易に行うことができます。

メーカー・型式

- ・メーカー：株式会社ディスコ
- ・型式：DAD3221

主な仕様

- ・対応ワークサイズ：Φ6inch(Φ152.4mm)
- ・対応ワーク厚さ：3mm
- ・最大対応ブレード径：Φ58mm
- ・ハブ/ハブレスブレードに対応
- ・オートアライメント、オートカーフチェック可能

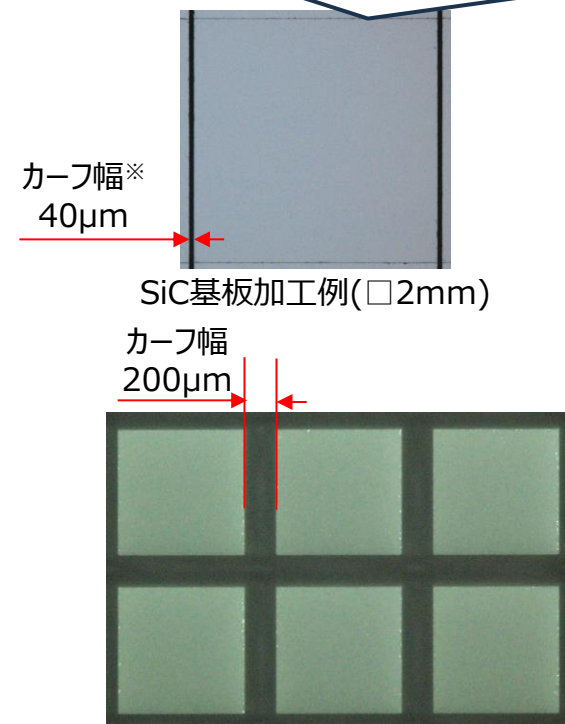
用途

- ・半導体や電子基板の完全切断
- ・表面からマイクロメートルオーダーの溝加工
- ・分析箇所切断・露出

適した加工条件の設定(送り速度、ブレード種類など)を行うことで、チップング(欠け)などの品質不良を低減することができます。



装置の外観



SiC基板加工例(□2mm)

カーフ幅
200μm

YSZ(イットリア安定化ジルコニア)基板
加工例(□1mm)

※カーフ幅 = ブレード厚み + ブレード振れ